

株式会社アドバンテスト

2025 年 3 月期(2024 年度)第 3 四半期決算説明会 質疑応答要旨

2025 年 1 月 29 日(水)

[FY2024 3Q 実績]

- Q1: 3Q の SoC テスタ売上は、2Q 比横ばいで推移しているのに対し、メモリ・テスタ売上は伸びが加速している。3Q で SoC テスタ、メモリ・テスタの需要に変化があったか。
- A1: 需要に何か特別な変化があったわけではない。SoC テスタ、メモリ・テスタともに顧客より強い需要をいただいております、3Q の実績は、要求納期に対して当社が出荷対応したことによるもの。

[CY2025 市場規模、シェアの見通し]

- Q2: CY2025 の事業環境で言及された「地政学リスク上昇に伴う先行き不確実性の増加」について、この増加の背景は何か。また、CY2025 のテスタ市場規模見通しは、幅広い予想を出されているが、その上限、下限となるシナリオはそれぞれ何か。この中で、SoC テスタ市場のビジビリティは、昨年 10 月に比べて上がっているか。
- A2: 不確実性が増加している背景には、例えば米中関係が非常に激しく変化していることなどがある。当社が世界中でビジネスを展開する中、このような地政学的要因が当社ビジネスに影響を及ぼすリスクを注視している。次に、CY2025 の市場規模予測について。予測の背景には、今年の後半頃から、SoC、メモリ共に、高性能半導体向けで次世代品がリリースされ、量産に移行されるタイミングに入ると見ている。SoC ではプロセスノードの変化、メモリでは積層数が増加するだろう。半導体の複雑性がさらに増す中、テストの複雑性やそのハードルがどの程度増すかについては推測しづらい。この背景から市場規模予測の幅は広めになる。CY2025 の SoC テスタ市場規模は、この半導体やテストの複雑性増加により前年比で伸びると予想するが、年後半に比べ前半の方がビジビリティが高い。やはり半導体の複雑性が先行きを予測しづらくしている。
- Q3: CY2024 および CY2025 における SoC テスタの市場規模の内訳とそれぞれの成長率を教えてください。
- A3: 市場規模の内訳について、当社の SoC テスタ売上のアプリケーション別内訳に基づきお答えする。市場規模のミッドポイントをとると、CY2024、CY2025 ともに、「コンピューティング・通信」が約 7 割、「車載・産業機器・民生・DDIC」が約 3 割の比率と見ている。成長率としては、「コンピューティング・通信」の伸びがやや大きいイメージを持っている。

Q4: CY2024 および CY2025 の市場シェア見通しを教えてください。また、御社の競合他社はカスタム ASIC 顧客による自社テスト採用についてコメントしているが、競争状況を教えてください。

A4: CY2025 の 4 月に CY2024 の市場シェアを開示する予定だが、CY2024 は想定通り推移したと考えている。第 3 期中期経営計画の目標値である 58%以上という目標に対して、想定線またはそれを上回るペースで推移したと見ている。CY2025 は、HPC/AI の顧客基盤拡大をもとに市場シェアの拡大を見込むが、その多くは「マグニフィセント・セブン」各社およびそれに関連するカスタム ASIC 関連向け。

[カスタム ASIC 向けテスト動向]

Q5: CY2025 の SoC テスタ需要で、GPGPU とカスタム ASIC ではどちらが御社にとってより強いけん引役となるのか。また、それぞれの市場規模を教えてください。御社は、今までもカスタム ASIC 向けテスト・ビジネスではさまざまなプロジェクトにかかわっていると谈及されていたが、CY2025 以降の見通しはいかがか。

A5: カスタム ASIC について、強気な見方をしている。詳細なコメントは差し控えるが、当社は、自社シリコンの開発を進める「マグニフィセント・セブン」やカスタム ASIC 開発を手掛けるパートナー企業を支えている。

[エッジ AI 関連半導体向けテスト動向]

Q6: FY2024 1Q-3Q の SoC テスタ売上の内、エッジ AI 関連はどの程度貢献したのか。また、CY2025 の SoC テスタ市場予測の中にはエッジ AI 向けをどの程度織り込んでいるか。

A6: 足元では、データセンタ向け AI が主要なドライバとなっており、インフラ系 AI の規模が相対的に大きい。エッジ AI は民生品などへの搭載が進んでいる。当社もその恩恵を受けており、FY2025 にかけてビジネス規模の成長を見込む。今までエッジ AI で主に連想されるのは、パソコン、タブレット、スマートフォンなどの民生品向けだと思うが、ロボティクスを含む産業機器向けにも普及しつつある。つまり、エッジ AI の領域が広がり、その定義が拡大することは、AI 関連半導体の数量にとってポジティブな示唆だといえる。

Q7: エッジ AI 向け半導体のテストタイムは、従来のエッジ端末用半導体と比べて長いと考えていいのか？

A7: 従来のエッジ端末用半導体と比べて複雑度が高く、多機能化しているエッジ AI のテストタイムは相対的に長い。ただし、複雑度と経済性の差異により、インフラ系 AI 向けのテストタイムには及ばないと思う。

[近縁市場とのパートナーシップ、ダイ・レベル・テスト]

- Q8: Technoprobe 社および FormFactor 社との提携による影響について。CY2026 および CY2027 に向けてウェハおよびダイ・レベルのテストが拡大して、市場規模が拡大するシナリオを見込めるか？または、提携による効果として効率化改善がもたらされれば、その結果、市場規模が縮小するか？市場規模および長期成長見通しへの考え方を教えてほしい。
- A8: 向こう2～3年はウェハまたはダイ・レベルでのテストを強化して最終製品の歩留まりを確保する動きが見込める。ご質問では、効率性の改善が進むのではないかとの見解を提起いただいたが、当社は複雑性を背景に、Known Good Die(KGD)*を確保することを目的に、ウェハ・テスト全体、およびダイ・レベルにおけるテスト回数が増えていると見ている。今回、このタイミングで提携に至った主な背景は、半導体およびテストの複雑化に起因する。ダイ・レベルでの良品保証には、高精度なダイ・レベル・テストが必要で、そのためには高性能な熱制御ソリューションが必須となる。つまり、テストとハンドリング、およびそれに関連するプローブカードも複雑度が増す。テスト、プローブカード、プローバー、ハンドラ単体ではなく、それらが共に技術の高度化に取り組み、トータル・テスト・ソリューションを開発する必要がある。CY2026～2027にかけてテスト効率改善が進むか否かは現時点では何とも言えない。ただ、ウェハ・テストの領域において事業機会が拡大することは確実だと見ている。同時に、チップレットを組み立てる段階でスクリーニングを行うファイナル・テストやシステムレベルテストも重要性を増している。

*Known Good Die (KGD): 品質を保証された良品のベア・ダイ

- Q9: CY2025 のテスト市場規模見通しにダイ・レベル・テスト市場も含まれているか？
- A9: CY2025 時点ではダイ・レベル・テストの本格的な貢献を見込むには時期尚早である。足元では、まだ初期評価段階である。量産需要はどちらかという、来年以降に発生するのではなかろうか。
- Q10: 御社がウェハおよびダイ・レベル・テストでタイムリーなソリューションを提供できるのであれば、これはユニークであり、御社の競合他社に対する優位性が高まるはずだ。メモリ顧客は2社購買方針だと思うが、御社が競合に先立って優れたソリューションを提供できるのであれば、御社のソリューションが業界スタンダードとなるのではないか。
- A10: 当社はテスト・ビジネスでとても良いポジションにある。業界標準となることを目指す一方で、顧客のテスト複雑性増加という課題解決に向け、高性能なテスト・ソリューションをタイムリーに提供することに努めている。そのためのエコシステムを構築していく考えであり、今後も主要パートナーとのパートナーシップを進めていきたい。

[SoC テスタの需要の持続性]

- Q11: 御社を含めた半導体製造装置の特需は、半導体の先端パッケージの歩留まりの低さがドライバーになっていると認識しているが、一方でその特需の反動を懸念している。御社は CY2025 のテスタ市場のさらなる成長を予想されているが、これは半導体の品質向上に向けたテスタ需要には持続性があるとの判断か。
- A11: 現時点で半導体の複雑性が減速するシナリオはあまり見ていない。顧客は半導体のパッケージ歩留まり改善、テストタイム短縮などのテスト効率化に取り組まれている。現世代の高性能半導体の生産規模と、次世代半導体の複雑性増加を考えると、おそらく品質やテスト面で新たなチャレンジが出るだろうとの推測に基づき、CY2025 のテスタ市場規模を予測している。ムーアの法則が続くことで、テストタイムが伸びることに加え、チップレットはこれから普及が始まり、そこに実装されるメモリ、CPU、GPU もより高度になる。したがって、ウェハ・レベルおよびダイ・レベルでのテスト回数が伸びるだろう。3D パッケージになると、より多くのデバイスが搭載されるようになる。また、シリコン・フォトニクスも複雑度を高める新たな要素だ。これらを踏まえると、複雑性が減速すると考えにくく、これらの先端パッケージ品の販売単価が高いことも背景に、テスト強化への意欲は引き続き高いものと認識している。半導体の生産数量の伸びが横ばいになったとしても、半導体の複雑性が減速しない限りテスト項目が少し増えるなどの要因で、既存のインストールベースへのテスタ能力増強など、テスタ需要増が期待できる。
- Q12: 最近、SoC 市場においてテスト・プロセスが変化し、テストタイムが短縮したという話も聞か、それにより御社の業績や CY2025 の SoC 市場規模見通しに影響が出たか。
- A12: その影響は認識していない。テスト項目は今後も増加すると見ている。

以上

※本資料に記載されている内容は、決算説明会の質疑をもとに当社の判断で要約したものです。また本資料には、将来の事象についての、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれております。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているものまたは暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。